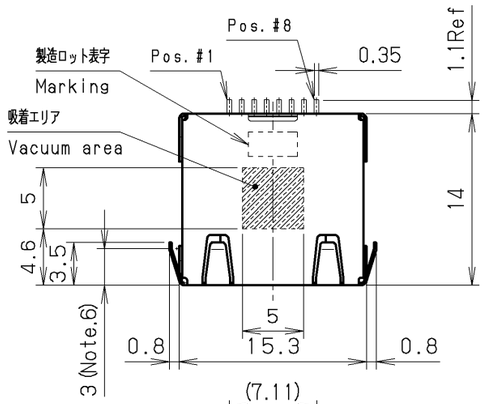
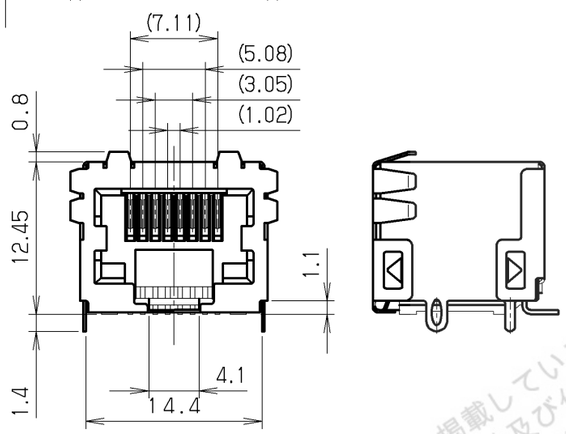
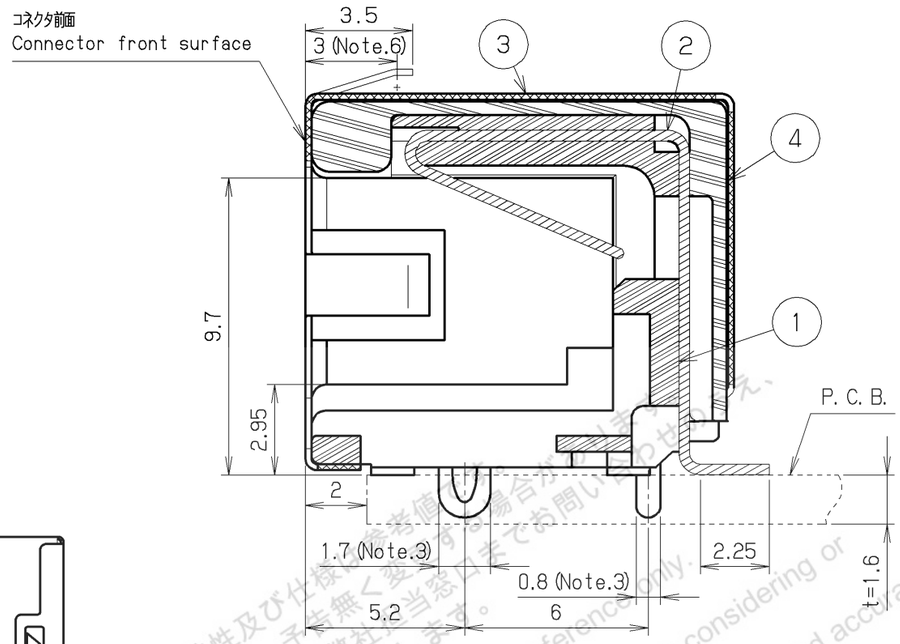
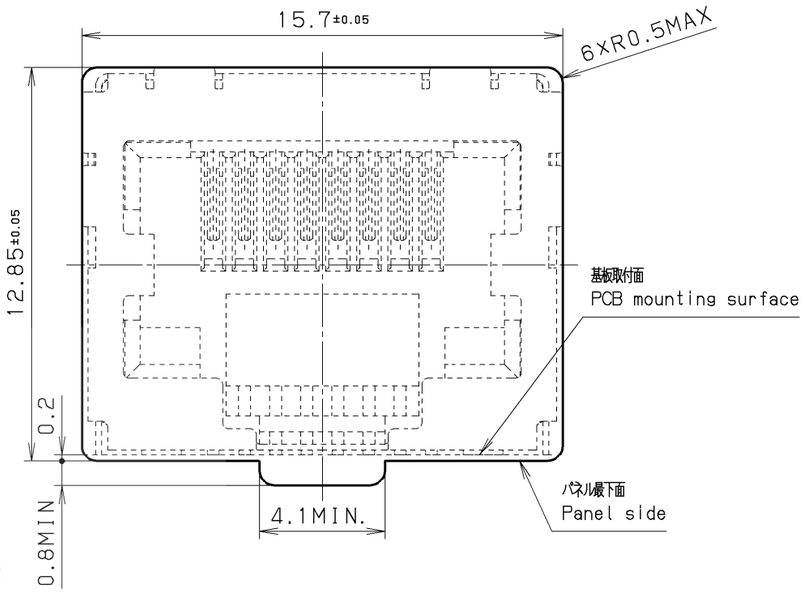




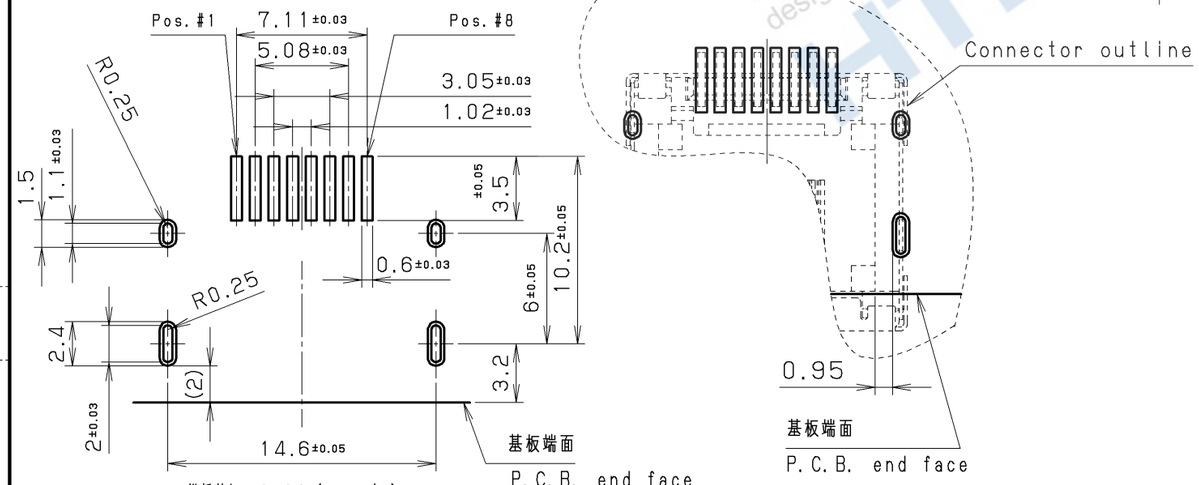
外観
Appearance



嵌合部詳細 (S=5/1)
Contact detail (S=5/1)



推奨パネル取付寸法 (S=5/1)
Recommended Panel Design (S=5/1)



推奨基板レイアウト (S=3/1)
Recommended P.C.B. layout

注1．コンタクト処理
接触部　：パラジウムニッケルめっき0.1μm以上
　　＋ 金めっき0.03μm以上
SMT部：金めっき0.03μm上
下地　：ニッケルめっき
注2．コプラナリティ：0.1mm以下
注3．シェル板厚　t=0.2mm
注4．コンタクト処理は、RJ-45の規格ではありません。
注5．リフローDIP対応品 (1リフロー実装を想定)

注6．パネル接触ばねの接点位置は、
コネクタ前面より3±0.3mmにて設計しています。

Note
1.Contact plating
Contact area　:Palladium-Nickel 0.1μm min.
　　＋ Gold 0.03μm min.
Termination area:Gold 0.03μm min.
Underplating　:Nickel
2.Coplanarity　:0.1mm max.
3.Shell thickness :t=0.2mm
4.Contact plating is not the standard of the RJ-45.
5.This Connector is met by reflow DIP.
(It is possible by once.)
6.The shield contacts are designed in 3±0.3mm
out of connector front surface.

RoHS compliant

番号 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY	処理 FINISH	備考 NOTE
4	絶縁体B Insulator B	PA9T(GF)	1	———	UL94V-0 BLACK
3	シェル Shell	りん青銅 Phosphor bronze	1	ニッケルめっき Nickel	———
2	コンタクト Contact	りん青銅 Phosphor bronze	8	注1 See Note 1	———
1	絶縁体A Insulator A	PA9T(GF)	1	———	UL94V-0 BLACK

改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT
3			
2			
1			

年月日 DATE	尺度 SCALE	単位 UNIT	3角法
Feb.17 (2017)	2/1	mm (INCH)	3RD. A. P

製図 DR.	設計 DE.	検図 CHK.	検図 CHK.	承認 APP.
S.WATANABE	S.WATANABE	K.OOAKU	———	K.HOMMA

HTK 本多通信工業株式会社
HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.

名称 NAME	RJ-45形モジュラージャック リバースSMT・パネル接地タイプ (RoHS) RJ-45 modular jack reverse SMT and panel earth type (RoHS)
製番 PART NO.	MOD-RJ88LY1GA+ REV.

ID= MOD-RJ88LY1GA+ B0

掲載している製品の特性及び仕様に参考値がある場合は、その参考値を、予告無く変更する場合がございますので、特性及び仕様については、弊社営業窓口までお問い合わせください。採用のご検討やご注文の際は弊社営業窓口までお問い合わせください。納入仕様書の取り交わしをお願いする場合があります。
The product information in this data is for reference only. Please request our sales office for the most current and accurate ordering information. This is subject to change without notice. Contact our sales office before considering or using any of our products. Please request Engineering Drawing for further information.
design information.